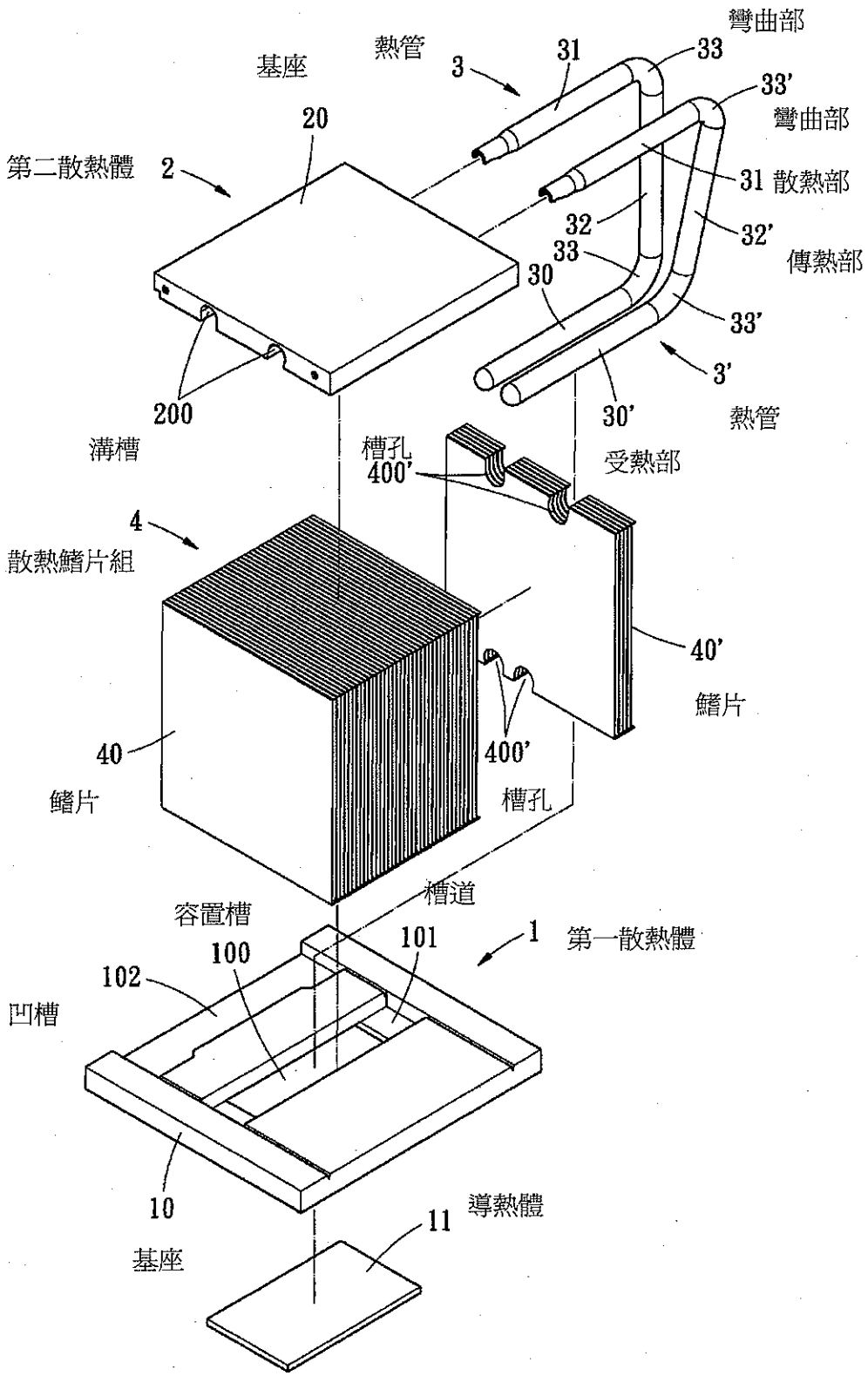
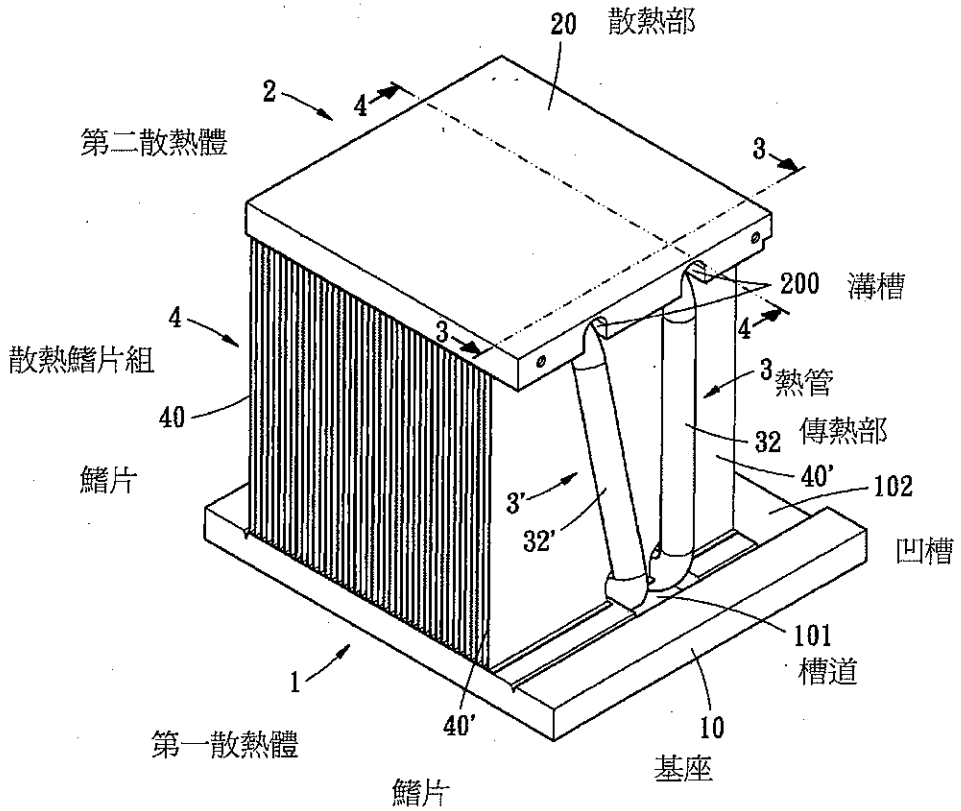
附圖 1：系爭專利之圖示



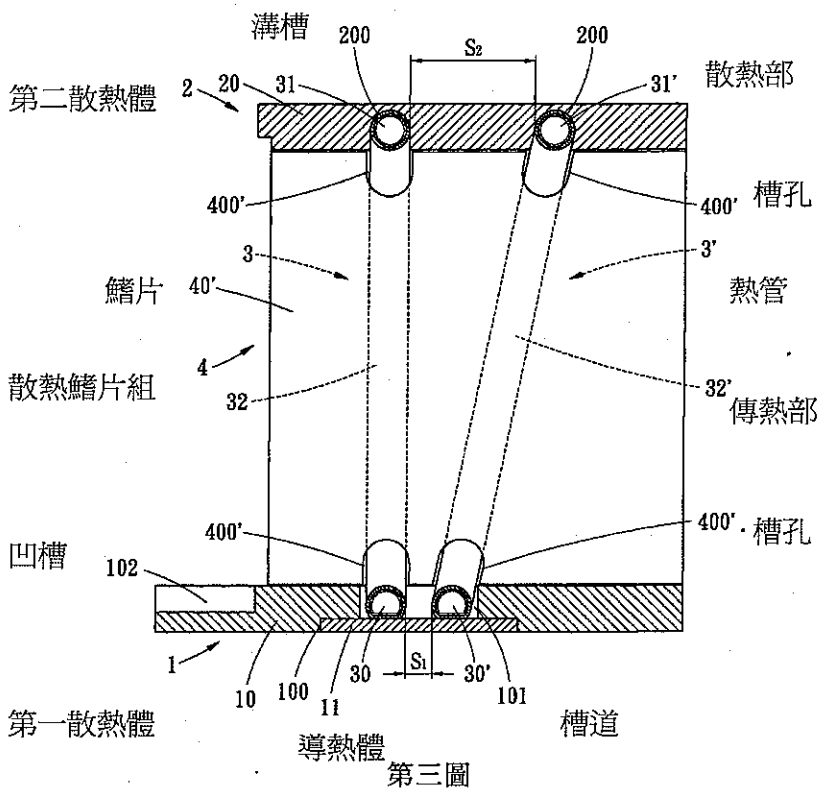
第一圖

第一圖 係為本創作之立體分解圖



第二圖

第二圖 係本創作之立體組合圖。



第三圖

第三圖 係第二圖之 3-3 斷面剖視圖。

附圖 2：引證 1 之圖示

引證 1 為 2001 年 2 月 20 日公告之美國第 6189601 號「HEAT SINK WITH A HEAT PIPE FOR SPREADING OF HEAT」案；

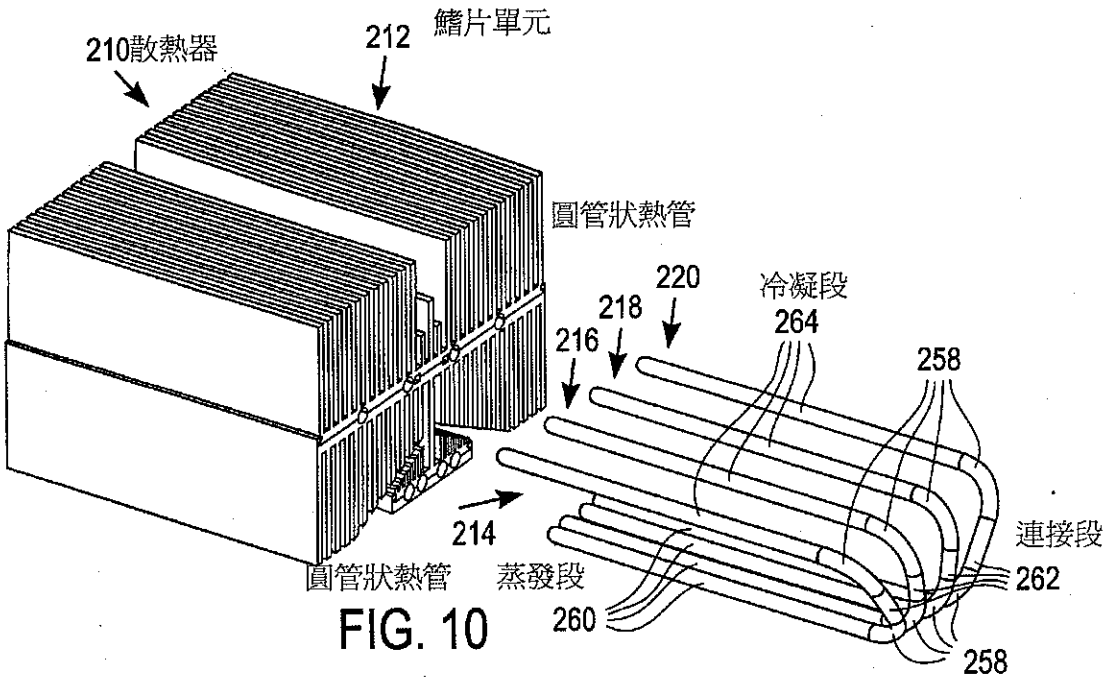


FIG. 10

FIG.10 為本發明另一實施例的散熱器

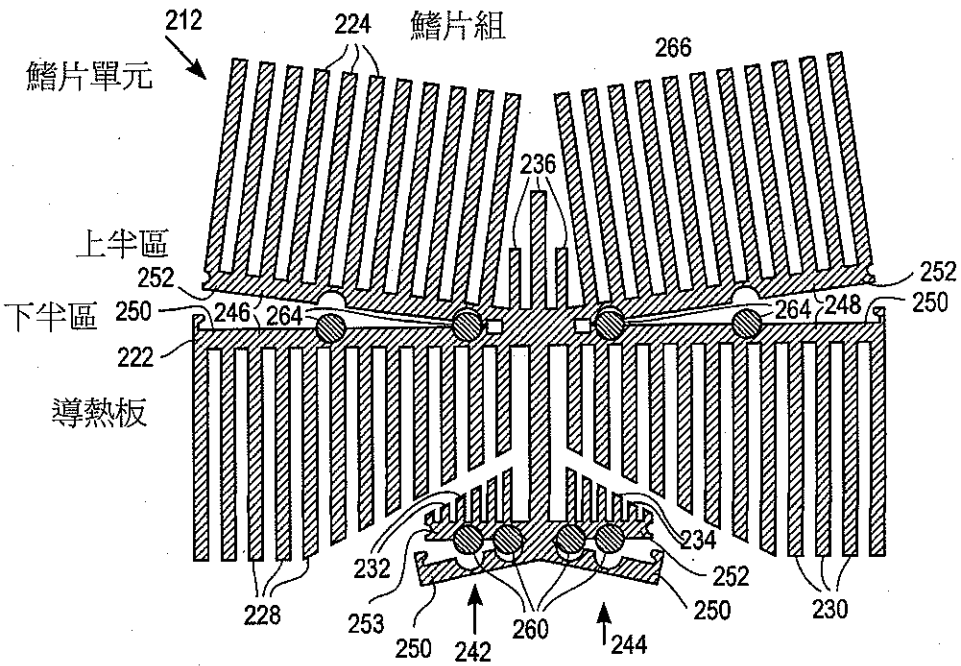


FIG. 11

FIG.11 為本發明另一較佳實施例之組合側視剖面示意圖

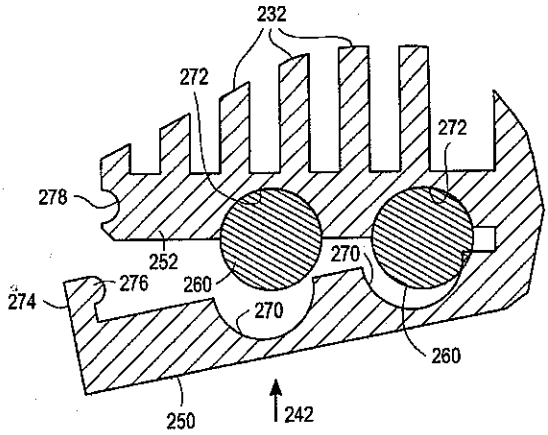


FIG. 12

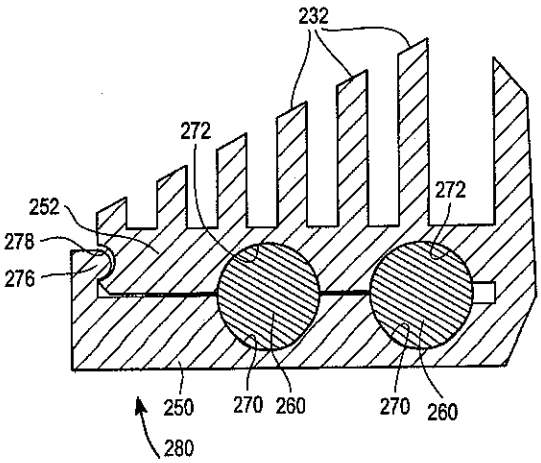
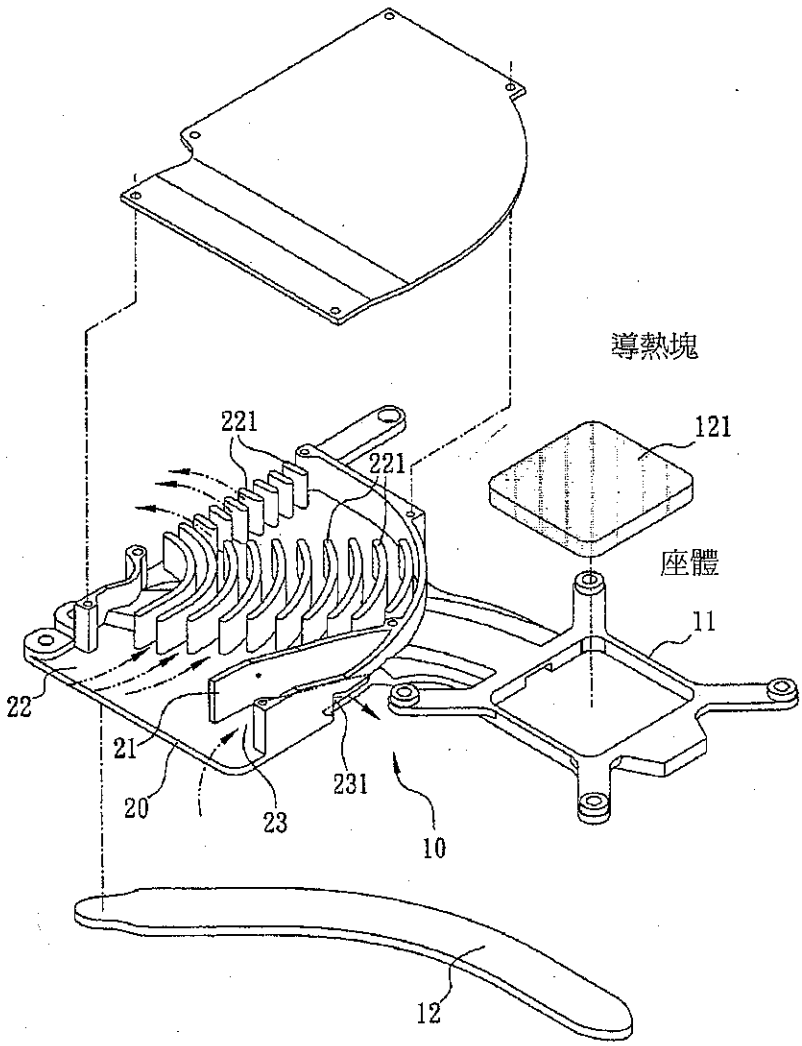


FIG. 13

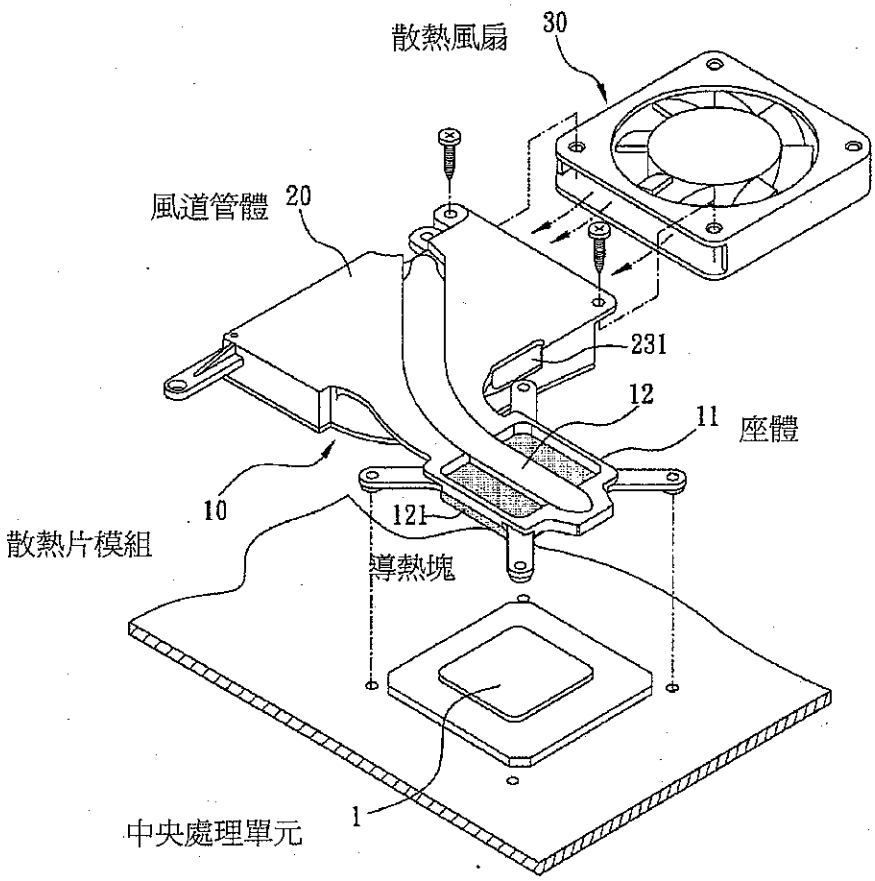
附圖 3：引證 2 之圖示

引證 2 為 91 年 11 月 21 日公告之第 90208261 號「電子產品內之散熱模組結構」專利案;



第一圖

第一圖係為本創作之立體分解示意圖。

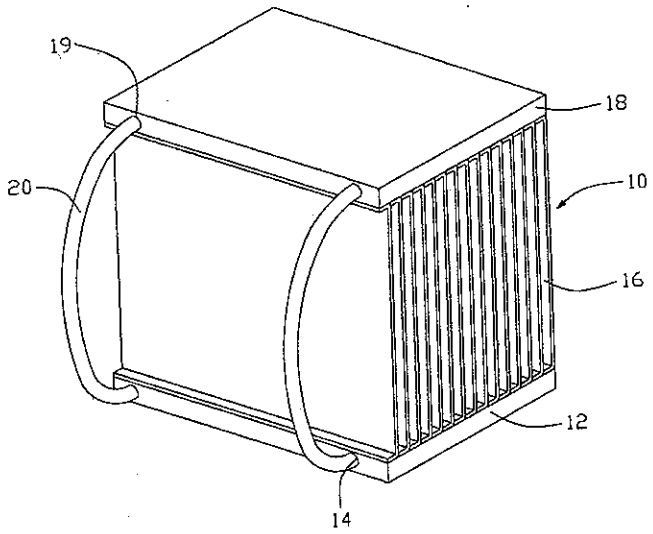


第二圖

第二圖係為本創作之實施示意圖。

附圖 4：引證 3 之圖示

引證 3 為 92 年 10 月 1 日公告之第 92200665 號「散熱裝置組合」專利案



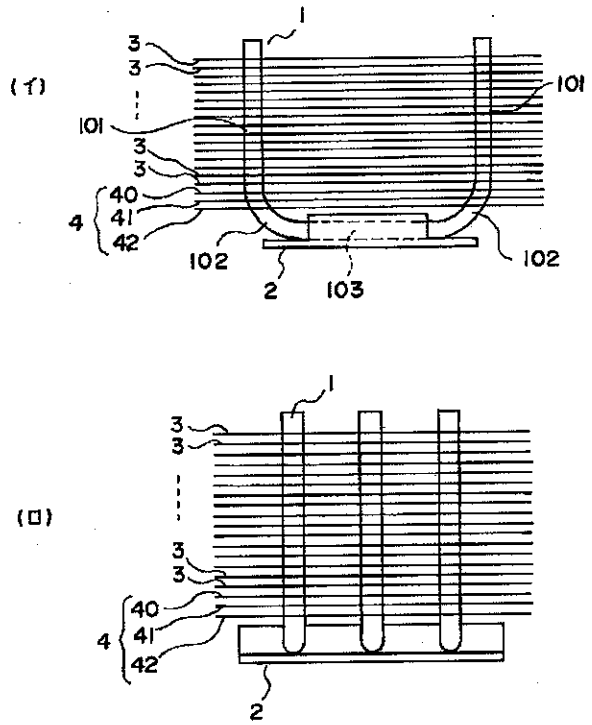
第一圖

第一圖係本創作散熱裝置組合之立體組合圖。

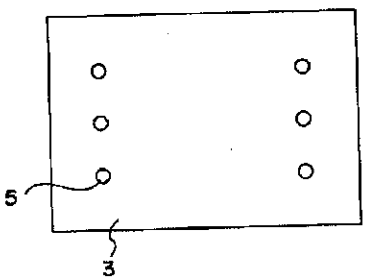
附圖 5：引證 4 之圖示

引證 4 為 1998 年 4 月 24 日公開之日本特開平 10-107192 號案

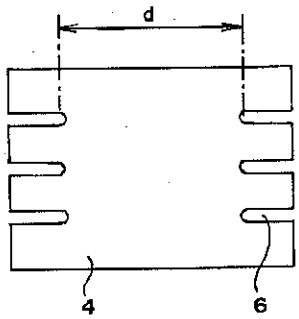
【図1】



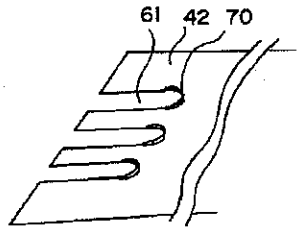
【図2】



【図3】

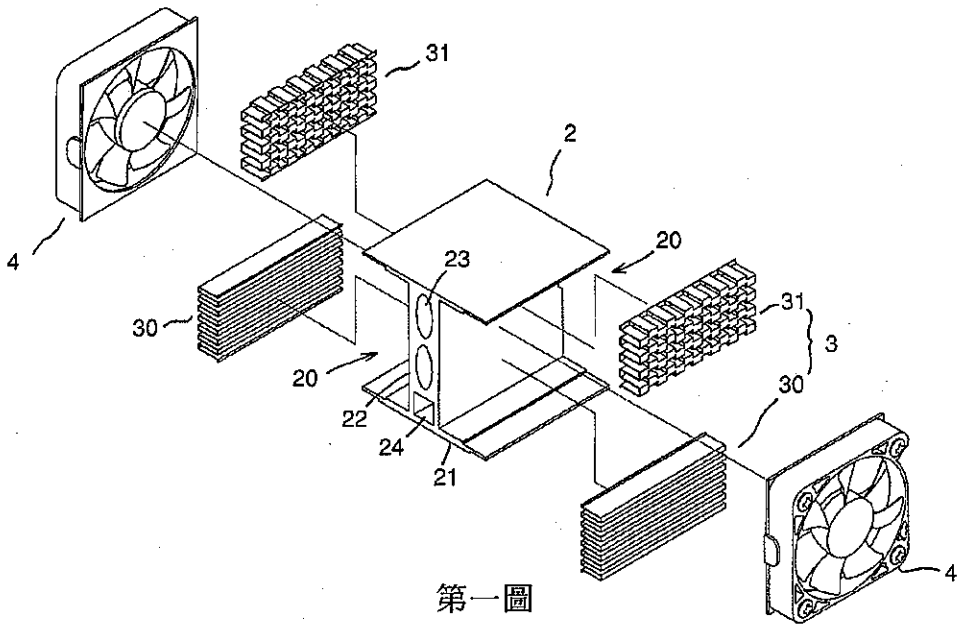


【図4】



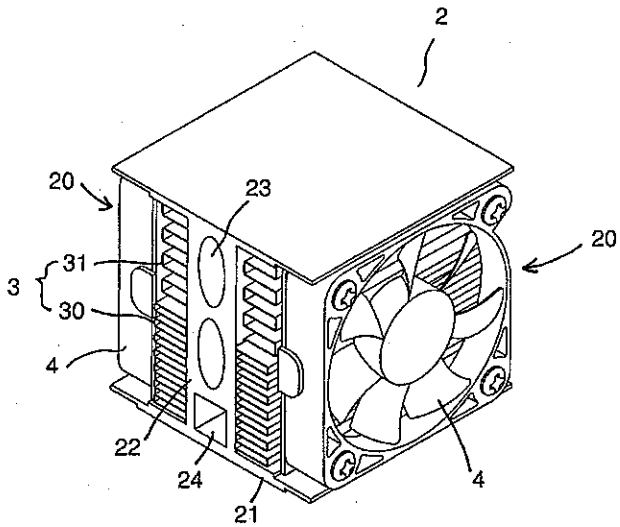
附圖 6：引證 5 之圖示

引證 5 為 91 年 3 月 21 日公告之第 89209127 號「CPU 散熱裝置之結構改良」專利案



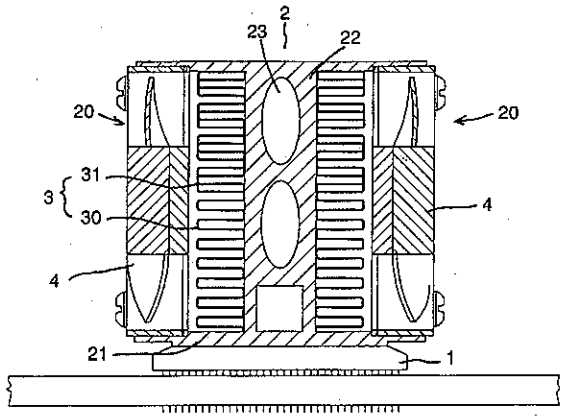
第一圖

第一圖，係本創作之立體分解圖。



第二圖

第二圖，係本創作之立體外觀圖。

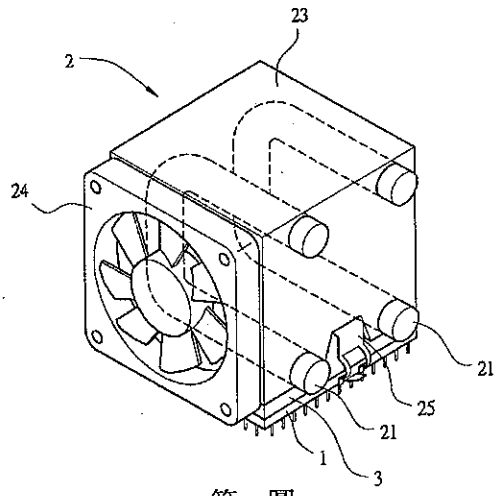


第三圖

第三圖，係本創作之組合剖面圖。

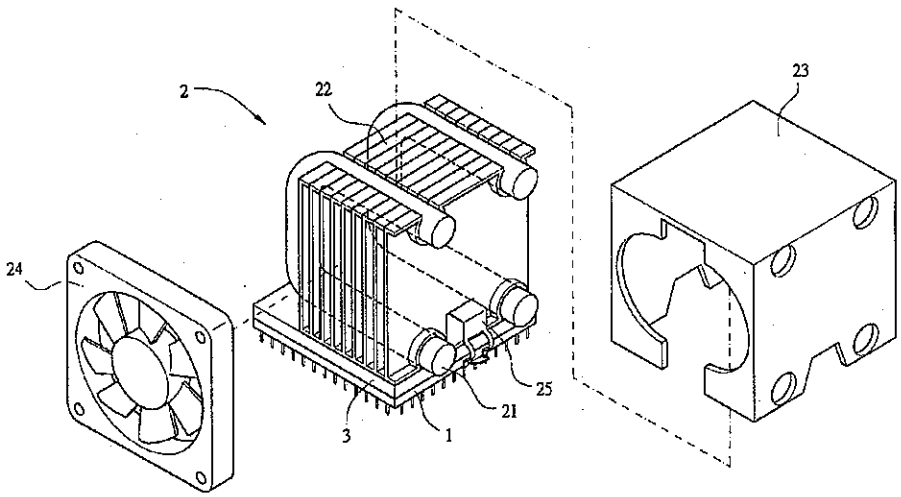
附圖 7：引證 6 之圖示

引證 6 為 91 年 7 月 11 日公告之第 90203392 號「中央處理器之熱導管散熱器結構改良」專利案



第一圖

第一圖 係本創作之立體圖



第二圖

第二圖 係本創作之立體分解圖

附圖 8：引證 7

引證 7 為 92 年 2 月 12 日公告之中國大陸新型專利第 02202773.4 號案

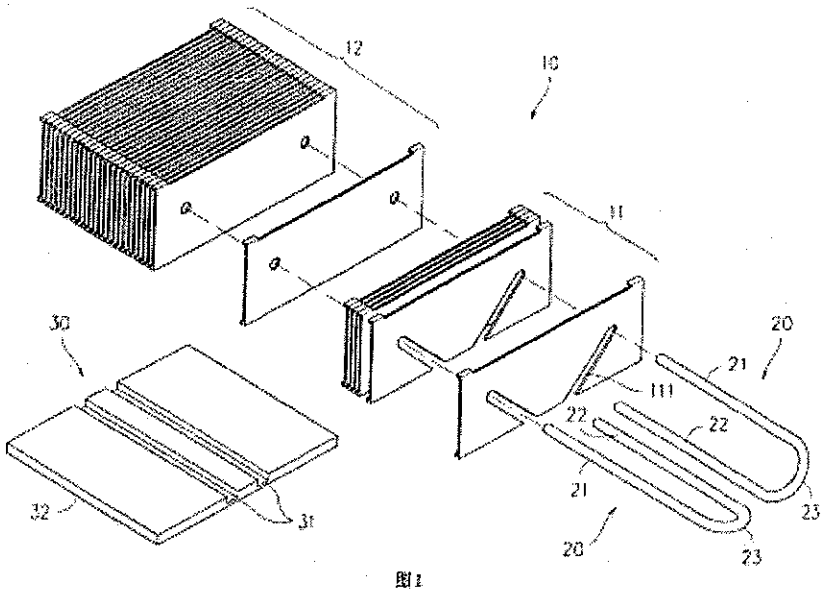


图1

圖 1 為本創作之立體分解圖

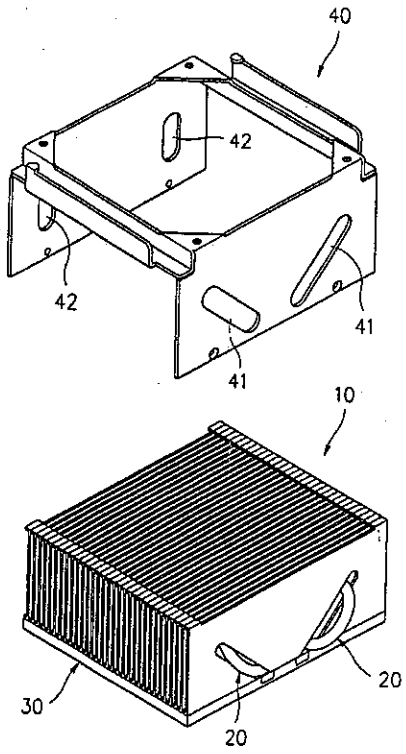


图2

圖 2 為本創作加設外蓋之立體分解圖